



意法半導體計畫收購恩智浦的 MEMS 感測器業務 強化汽車與工業應用布局

- **ST 簽署協議，將以最高 9.5 億美元現金收購 NXP 的 MEMS 感測器業務，其中 9 億美元為預付金額，另有 5,000 萬美元視技術進展達成狀況支付**
- **ST 與 NXP 的 MEMS 業務在技術與產品組合上具高度互補性，合併後的產品線將涵蓋汽車、工業與消費性市場，具良好平衡**
- **NXP 的 MEMS 業務在 2024 年的營收約為 3 億美元，其毛利率與營業利益率對 ST 具有明顯挹注效果。**
- **此全現金交易將以 ST 現有資金支付，預期自交易完成後即對每股盈餘帶來貢獻**

【臺北訊，2025 年 7 月 25 日】— 服務橫跨多重電子應用領域之全球半導體領導廠商意法半導體 (STMicroelectronics，簡稱 ST；紐約證券交易所代碼：STM) 宣布，將強化其全球感測器事業布局，計畫收購恩智浦半導體 (NXP Semiconductors，那斯達克代碼：NXPI) 的 MEMS 感測器業務。此次交易將進一步強化並擴充 ST 在 MEMS 感測器技術與產品線的既有優勢，開啟汽車、工業及消費性市場的全新發展契機。

意法半導體類比、電源與離散元件、MEMS 與感測器事業群總裁 Marco Cassis 表示，「這項預計進行的收購案，與 ST 整體策略高度契合。整合現有的 MEMS 產品組合與這些互補性高的技術與客戶關係，將進一步鞏固我們在汽車、工業與消費性應用等關鍵市場的感測器領域地位。透過 IDM 模式，整合技術研發、產品設計與先進製造能力，將為全球客戶提供更完善的服務。」

恩智浦 (NXP) 類比與車用嵌入式系統事業部執行副總裁暨總經理 Jens Hinrichsen 則表示，「NXP 是車用 MEMS 動作與壓力感測器的領先供應商，長期以來深受客戶採用。然而，經過審慎的產品組合檢視後，我們認為該業務已不再符合公司的長期策略方向。我們與意法半導體達成共識，這項產品線將能完善補強 ST 的產品組合、製造資源與策略藍圖。我們也很欣慰，MEMS 感測器團隊未來將在 ST 獲得穩定與長遠的發展機會。」

此次由 ST 收購的 MEMS 感測器產品組合，主要聚焦於車用安全感測，包括被動安全（如氣囊）與主動安全（如車輛動態控制）應用，同時涵蓋監測用途的感測器，例如胎壓監測 (TPMS¹)、引擎管理、舒適性與防盜功能。此外，亦包含用於工業應用的壓力感測器與加速度計。面對快速成長的車用 MEMS 市場，ST 可望發揮既有與車用一階供應商的穩固合作關係，並透過創新藍圖持續深化布局。

¹ 胎壓監測系統 (Tire Pressure Monitoring System)

MEMS 技術在安全性、電動化、自動化與車聯網等領域正日益發揮關鍵功能，進一步帶動未來營收成長的潛力。

根據預測，汽車用 MEMS 慣性感測器的成長速度將超越整體 MEMS 市場。該項業務於 2024 年創造約 3 億美元營收，且其毛利率與營業利益率皆將明顯挹注 ST 整體獲利，並預期自交易完成後即對意法半導體的每股盈餘 (EPS) 帶來正向貢獻。

此次收購將強化 ST 在 MEMS 感測器的技術領先優勢、產品研發實力與藍圖規劃，進一步充實其在汽車安全應用的核心智慧財產與技術組合，同時也納入一支具高度專業技術背景的研發團隊。整合後的業務將進一步發揮 ST 在 MEMS 垂直整合製造商 (IDM) 模式的優勢，涵蓋從設計、製造到測試與封裝的全流程，進一步加速創新週期並提升產品客製化彈性。

意法半導體與 NXP 已簽訂最終交易協議，總收購金額最高達 9.5 億美元，其中 9 億美元為前期付款，另有 5,000 萬美元將視技術里程碑達成情況支付。本次交易將由 ST 現有資金支應，並需符合慣常成交條件，包括相關監管機關核准，預計於 2026 年上半年完成。

前瞻性資訊聲明

本新聞稿中部分非屬歷史事實的敘述，為根據 1933 年《美國證券法》第 27A 條與 1934 年《美國證券交易法》第 21E 條 (均經修訂) 所定義的前瞻性聲明。這些聲明是根據本公司管理階層目前的看法與假設所做出，並涉及已知與未知的風險與不確定性，可能導致實際結果、表現或事件與此類聲明所預期的情況有顯著差異。影響因素包括但不限於：

- 全球貿易政策的變化，包括關稅與貿易障礙的新增與擴大，可能影響整體宏觀經濟情勢，進而直接或間接衝擊對本公司產品的需求；
- 宏觀經濟與產業趨勢的不確定性 (例如通貨膨脹與供應鏈波動)，可能影響本公司產能與終端市場對產品的需求；
- 客戶需求與預測不符，可能使本公司需採取轉型措施，而這些措施未必能如預期帶來預期效益；
- 能否在技術迅速演進的環境中持續設計、製造並銷售具創新性的產品；
- 我們、本公司客戶或供應商營運所在地的經濟、社會、公共衛生、勞動、市政建設或政治條件變化，例如因整體經濟或區域事件、地緣政治與軍事衝突、社會動盪、勞工抗爭或恐怖活動所導致者；
- 出乎預期的事件或情勢，可能影響本公司執行計畫與 / 或達成研發與製造計畫目標的能力，而這些計畫係受惠於公共資金的支持；
- 本公司主要代理商發生財務困難，或關鍵客戶大幅縮減採購規模；
- 本公司生產設施的稼動率、產品組合與製造效能，以及履行與供應商或第三方製造商所保留產能所需的出貨量；
- 營運所需之設備、原物料、公用事業資源、第三方製造服務與技術，或其他供應品的可得性與成本 (包括因通膨導致的成本上升)；
- 資訊系統的功能與效能，該系統支援製造、財務與銷售等關鍵營運活動，亦面臨資安威脅，以及本公司或客戶、供應商、合作夥伴與第三方授權技術提供者之資訊系統遭入侵的風險；

- 有關員工、客戶或其他第三方的個人資料遭竊取、遺失或不當使用，以及違反資料隱私法規的情況；
- 競爭對手或其他第三方提出的智慧財產權主張所造成的影響，以及本公司能否在合理條件下取得所需授權；
- 因稅法修訂、新制定法規、稅務查核結果，或國際租稅協定變更，導致整體稅務狀況出現變化，進而影響營運結果，以及正確評估稅額抵減、優惠、扣除與提列準備金的能力，並能否如期認列遞延所得稅資產；
- 外匯市場波動，特別是美元兌歐元及其他主要營運貨幣的匯率變動；
- 既有訴訟案件的結果，以及未來如成為被告所可能面臨的新訴訟所帶來的影響；
- 產品責任或保固相關索賠，包含因疫情或交貨失敗引發的索賠，或其他與本公司產品有關的訴訟，以及客戶針對含有本公司零組件產品所發起的召回行動；
- 天災等自然事件，例如嚴重天候、地震、海嘯、火山爆發或其他天然災害，以及氣候變遷的影響、健康風險與本公司、客戶或供應商所在地的流行病或疫情；
- 產業中日益增多的法規與政策倡議，包含關於氣候變遷與永續發展的相關議題，以及本公司致力於在直接與間接排放（範疇一與範疇二）、產品運輸、差旅與員工通勤排放（範疇三重點項目）全面達成碳中和目標，並在 2027 年底前全面使用再生電力的目標。
- 傳染病或大流行疫情，可能對全球經濟造成長期且重大的負面影響，進而對本公司的業務與營運成果產生重大不利影響；
- 產業結構變動，例如供應商、競爭對手與客戶之間的垂直整合或水平整併所帶來的影響；
- 新專案的順利量產進程，其成功與否可能受限於本公司無法掌控的因素，包括關鍵第三方元件的可用性，以及分包商是否能符合本公司預期之效能；
- 個別客戶對特定產品的實際使用情境可能與預期用途不同，導致效能表現（如能源使用量）出現差異，進而影響本公司既有的減碳目標，甚至可能引發法律爭議或產生額外的研究成本。

本新聞稿所載之前瞻性陳述，均涉及各項風險與不確定性，實際結果與本公司業務表現可能與此等前瞻性陳述有所差異，甚至產生重大不利影響。部分前瞻性陳述可透過以下用語辨識，例如：「相信」、「預期」、「可能」、「預估將」、「應當」、「有望」、「尋求」、「預見」等，或是其他類似表達方式，亦可能以否定語氣或變化型出現，或透過對策略、計畫或意圖之描述呈現。

上述風險因素部分已載於本公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度，依據美國證券交易委員會（SEC）規定提交之 20-F 表格年度報告中「項目三：關鍵資訊 - 風險因素」章節，並有更詳細說明。若上述任一風險或不確定性發生，或所依據之基礎假設不正確，實際結果可能與本新聞稿中所述之預期、信念或推估情形有重大差異。本公司無意亦不承擔任何義務，就本新聞稿所提及之產業資訊或前瞻性陳述，因事後事件或情勢變動而進行更新或修正。

上述因素或本公司不時於提交美國證券交易委員會（SEC）文件中「項目三：關鍵資訊 - 風險因素」所列之其他因素，如出現不利變化，均可能對本公司之業務或財務狀況造成重大不利影響。

關於意法半導體

意法半導體 (ST) 擁有約 50,000 名專業人士，專注於半導體技術的設計與製造，並透過先進的生產設施掌握完整的供應鏈運作。作為一家垂直整合製造商，ST 與超過 200,000 家客戶與數千個合作夥伴緊密合作，攜手打造產品、解決方案與技術生態系，致力於共同拓展創新機會並面對技術挑戰，同時邁向更永續的未來。公司的技術廣泛應用於智慧交通、電力與能源管理優化，以及雲端連網自主裝置的規模化部署。我們正積極朝碳中和目標邁進，涵蓋範疇一與範疇二的所有直接與間接排放，並聚焦於產品運輸、差旅與員工通勤等範疇三排放。此外，ST 承諾在 2027 年底前全面達成 100% 使用再生電力的目標。更多資訊請參見：www.st.com。